

國立臺北科技大學 函

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段
一號

承辦人：賴建成

電話：02-27712171#6020

電子信箱：lks@ntut.edu.tw

受文者：屏東縣立東港高級中學

發文日期：中華民國113年8月15日

發文字號：北科大產學字第1137900218號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：113年半導體先進封裝測試工程師教師研習營課程表
(113F900672_1_15102423490.pdf)

主旨：本校辦理113年「半導體先進封裝測試工程師教師研習營」課程資訊（詳如說明），敬邀貴校教師踴躍報名參加，並請協助公告，請查照。

說明：

- 一、依據技術及職業教育法第二十六條第一項規定：「技職校院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員或專業及技術教師，每任教滿六年應至與技職校院合作機構或與任教領域有關之產業，進行至少半年以上與專業或技術有關之研習或研究」，辦理教師實務研習課程。
- 二、半導體技術日新月異進步、發展中，先進封裝技術已成為推動電子產業創新的關鍵。本課程希望能夠協助教師們掌握最新的半導體封裝與測試技術，希望藉由專業的培訓與互動交流，提升教學品質，技術面與知識面能夠無縫接軌，進而傳承、培養更多高素質的半導體技術人才。
- 三、報名資格：國內各大技專校院及高中職在職教師。
- 四、課程時間：113年8月28日（三）、8月29日（四），共計2



天，凡參與全程課程，且符合報名資格者，將於課程結束後核發研習時數證明電子檔。

五、課程地點：明新學校財團法人明新科技大學（新竹縣新豐鄉新興路1號）

六、人數上限：實體25人。（課程免費）

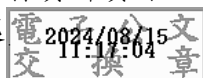
七、報名網址：<https://forms.gle/vpk8L5xzG3wuTDoy5>

八、活動聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學賴專員，連絡電話:(02)2771-2171分機6020，電子郵件：lks@mail.ntut.edu.tw。

九、檢附「半導體先進封裝測試工程師教師研習營」課程表。

正本：各私立大專校院、各公私立高級中學、各公私立高級職業學校

副本：明新學校財團法人明新科技大學半導體學院張合院長、新學校財團法人明新科技大學半導體學院趙守嚴副院長、力成科技股份有限公司何信松資深工程師、力成科技股份有限公司林賢昇資深工程師、力成科技股份有限公司黃志賢資深工程師、本校產學合作處



113 年「半導體先進封裝測試工程師教師研習營」課程

日期：113 年 8 月 28 日（三）和 113 年 8 月 29 日（四）

地點：明新科技大學逢喜樓 209 教室及半導體人才培育基地（新竹縣新豐鄉新興路 1 號）

時間：09:00~18:00（報到時間 08:50~09:00，中午休息時間 12:00~13:00）

人數：25 人（皆為實體，無線上授課）

活動內容：

日期	時間	課程名稱	授課教師	地點	
8/28 (三)	08:50~09:00	報到		明新科技大學 逢喜樓 209 教室	
	09:00~12:00	半導體製程概論	明新科技大學 半導體學院 趙守嚴副院長		
	12:00~13:00	午餐			
	13:00~17:00	晶圓切割機操作實務	力成科技股份有限公司 何信松 資深工程師		明新科技大學 半導體人才培育基地
	17:00~18:00	Q & A			
8/29 (四)	08:50~09:00	報到		明新科技大學 半導體人才培育基地	
	09:00~12:00	黏晶機操作實務	力成科技股份有限公司 林賢昇 資深工程師		
	12:00~13:00	午餐			明新科技大學 逢喜樓 209 教室
	13:00~17:00	打線機操作實務	力成科技股份有限公司 黃志賢 資深工程師		明新科技大學 半導體人才培育基地
	17:00~18:00	Q & A			

備註：

1. 本次研習課程為期 2 天，需參與全程課程，且符合報名資格者（全國在職之技專校院教師及高中職教師），將於課程結束後核發研習時數證明電子檔。
2. 填寫並提交課程報名表單後即可視為報名成功，若後續因報名資格不符或額滿等因素而無法錄取，主辦單位將提前另外以 Email 通知。
3. 主辦單位保留報名資格審核權，修改或變更活動內容及額滿提前截止報名之權利。
4. 本研習為免費課程，報名者無須負擔報名費。
5. 8 月 28 日（三）和 8 月 29 日（四）兩天將於課前和課後提供交通接駁往返臺北車站及上課地點，請於報名表單中填寫是否搭乘接駁車。

活動聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學 賴專員

連絡電話：(02)2771-2171 分機 6020，Email：lks@mail.ntut.edu.tw